（上接 114 版）

2、2025 年度第四季度

（1）半导体封装装备

单位：万元

序号	客户名称	开始合作时间	关联关系	交易内容	收入确认依据	收入金额	期末应收账款余额	期后回款金额
1	南通华达微电子集团股份有限公司	1997年6月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	1,180.36	993.34	101.78
2	中国华润有限公司	2003年11月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	964.96	3,593.95	1,866.33
3	大连理工大学	2025年3月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书	884.96	—	—
4	ADVANCE PRECISION AUTOMATION INDUSTRY SDN. BHD.	2025年6月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	878.85	857.51	844.87
5	天水华天科技股份有限公司	1997年11月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	604.97	3,710.51	1,294.18
6	吉光半导体（绍兴）有限公司	2023年5月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	479.10	506.79	395.35
7	无锡紫光集电科技有限公司	2024年1月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	461.49	321.58	59.28
8	深圳市合力微半导体有限公司	2025年6月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	274.34	84.00	—
9	深圳市咏辉半导体设备有限公司	2025年5月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	200.73	128.97	—
10	深圳市明微电子股份有限公司	2017年6月	非关联方	半导体封装设备及模具等	设备运行确认书/签收单据	173.20	197.17	0.65
合计		—	—	—	—	6,111.56	10,383.83	4,562.44

注：上表 2025 年四季度前十大客户中，部分客户为 2025 年与公司首次合作。其中大连理工大学属于国内科研院所，该校通过主动与公司取得联系后，购买公司半导体封装设备与模具，以用于该院教学与研究所用。

深圳市合力微半导体有限公司属于国内半导体封装企业，公司通过市场走访以及技术交流、产品推荐等方式成功与该客户形成合作关系，该客户使用公司设备与模具以进行半导体产品的封装工序。

深圳市咏辉半导体设备有限公司属于国内半导体封装企业，该客户主要源于公司其他客户推荐后与公司形成合作关系，采购公司设备与模具以用于半导体产品的封装工序。

ADVANCE PRECISION AUTOMATION INDUSTRY SDN. BHD.为马来西亚半导体设备服务商，该客户主要源于行业内其他客户推荐后与公司形成合作关系，采购公司设备与模具以用于半导体产品的生产。

（2）冲压轴承座及配套密封件

单位：万元

序号	客户名称	开始合作时间	关联关系	交易内容	收入确认依据	收入金额	期末应收账款余额	期后回款金额
1	Rulli Rulmeca SpA	2024年9月	非关联方	轴承座及密封件	报关单/提单/签收单据	176.06	143.08	203.86
2	GRUPOBECO	2014年8月	非关联方	轴承座及密封件	报关单/提单	61.53	26.29	26.14
3	NEPEAN CONVEYORS PTY LTD	2014年5月	非关联方	轴承座及密封件	报关单/提单	56.05	51.19	72.42
4	STM INDUSTRIALE SPA	2022年11月	非关联方	轴承座及密封件	报关单/提单	40.50	-32.16	25.00
5	SUPERIOR INDUSTRIES DO BRASIL LTDA	2025年10月	非关联方	轴承座及密封件	报关单/提单	32.56	—	30.94
6	河南神火集团新利达有限公司	2024年8月	非关联方	轴承座及密封件	签收单据	32.20	6.20	63.78
7	安徽怀陵进出口贸易有限公司	2013年4月	非关联方	轴承座及密封件	签收单据	28.17	-5.64	28.84
8	铜陵天高工贸有限公司		非关联方	废料收入	签收单据	26.59	—	—
9	KUNSTMANN CHILE SA	2017年7月	非关联方	轴承座及密封件	报关单/提单	22.67	—	—
10	HI-TECH HYDRAULIC ENGINEERS	2015年1月	非关联方	轴承座及密封件	报关单/提单	20.18	—	25.2
合计		—	—	—	—	496.81	189.06	453.50

（3）塑料挤出模具及配套设备

单位：万元

序号	客户名称	开始合作时间	关联关系	交易内容	收入确认依据	收入金额	期末应收账款余额	期后回款金额
1	Liability Limited Tajik-Turkish Joint Company "Afrang Plastic"	2024年4月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	182.93	-20.17	—
2	Trusscore Alberta Inc.	2025年3月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	81.65	10.04	5.66
3	ADOPEN PLAST"K VE "NT" AAT SANAY? A.?.	2006年8月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	68.24	6.70	20.53
4	义乌市米拉尼贸易有限公司	2020年12月	非关联方	塑料型材挤出模具	设备运行确认书	47.79	-10.58	—
5	Fenplast Window and Door	2004年12月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	43.87	-14.54	4.27
6	"KONFOR GMBH"LLC	2025年5月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	41.63	—	—
7	OXXO ALGERIE SPA	2025年10月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	34.46	3.58	—
8	KERUEN PLUS LLP	2025年6月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	28.22	1.27	—
9	AL MIMARI IND.CO.	2009年6月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	24.89	-0.84	—
10	North Star manufacturing, inc	2006年5月	非关联方	塑料型材挤出模具	报关单/提单	21.56	-10.37	—
合计		—	—	—	—	575.22	-34.91	30.46

注：以上客户均以集团口径列示；期末应收账款负数余额系重分类至合同负债的金额；期后回款金额超过期末应收账款余额，主要系期后新增订单产生的回款。

扣除众合半导体影响后的四个季度的收入分别为 6,937.65 万元、8,190.06 万元、6,470.06 万元、9,193.51 万元，其中第四度季度收入增长主要来源于大连理工大学与 ADVANCE PRECISION AUTOMATION INDUSTRY SDN. BHD.两家客户，上述客户于第四季度分别实现收入 884.96 万元、878.85 万元，成为公司第四季度收入增长的重要影响因素。上述客户合作背景详见“问题 2 二、2、（1）半导体封装装备”。

公司按照企业会计准则规定，以商品控制权转移、设备安装调试完成、客户验收合格作为收入确认依据，公司的收入确认政策保持一贯性。公司收入的季节性波动符合公司产品交付及验收的实际情况，与以往年度及同行业不存在重大差异，不存在第四季度突击或跨期确认收入的情况。

（二）会计师核查程序及核查意见

1、核查程序

（1）获取 2025 年全年及第四季度分业务板块的前十大客户清单，包括客户名称、开始合作时间、交易内容、收入确认金额、期末应收账款余额及期后回款情况；

（2）通过企查查等公开渠道分别对 2025 年全年及第四季度分业务板块的前十大客户的基本信息（包括股权结构、董监高信息、注册资本、成立时间等）进行核查；获取并检查公司关联方关系及关联交易清单，核查上述客户是否与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系；

（3）①检查公司与主要客户签订的销售合同或订单，核对合同关键条款；②获取发货单据、物流记录、客户签收单或验收单等支持性文件，验证交易的真实性；③对主要客户执行函证程序，未回函部分执行替代测试；④获取期后回款记录，检查回款是否存在异常；

（4）①分析第四季度收入占全年比例，与历史同期数据进行对比，判断是否异常；②结合客户订单交付周期、年底验收大客户等情况，分析第四季度业绩大幅增长的合理性；③检查是否存在年末突击发货、提前确认收入或跨期确认收入的情形；

（5）对临近资产负债表日的收入记录执行截止测试，检查销售合同、订单、发票、验收单等支持性文件，确认收入是否记录在正确的会计期间。

2、核查意见

扣除众合半导体影响后第四季度收入占比为 29.86%，第四季度业绩增长主要系该季度大连理工大学与 ADVANCE PRECISION AUTOMATION INDUSTRY SDN. BHD.两家客户确认收入金额较大，符合公司实际经营情况，不存在年末突击交易或跨期确认收入的情况。

三、说明公司信用政策变化情况、赊销增加的原因及合理性以及后续是否存在收回风险，结合预期信用损失率确定方法及过程，说明坏账准备计提是否充分。

（一）公司信用政策变化情况、赊销增加的原因及合理性

剔除收购众合半导体的影响，公司期末应收账款较上期增加 20.21%，具体数据列示如下：

单位：万元

内容 年度	2025年度 /2025 年 12 月 31 日	2024年度 /2024 年 12 月 31 日	增减比例
营业收入（剔除众合半导体后）	30,791.26	31,437.53	-2.06%
应收账款余额（剔除众合半导体后）	25,080.46	20,863.86	20.21%

报告期内公司给予主要客户的信用政策并未发生变化，应收账款的增加主要受公司业务结构及部分客户付款周期延长的影响，公司营业收入主要由半导体塑封模具及设备产品构成，根据客户资质、所处行业、信誉度，与客户合作关系、销售订单稳定状况等给予客户相应的信用额度和账期，2025 年公司半导体塑封模具及设备产品销售占比提升，而该类产品的销售回款周期通常高于其他类型产品，叠加部分客户因资金安排、付款审批等因素延长了回款周期，共同导致公司的应收账款余额的增长。

结合同行业可比公司的情况，公司 2025 年度（剔除并表众合半导体的影响）赊销率增加的合理性分析下：

单位：万元

可比公司	营业收入	营业收入增减比例	应收账款	应收账款增减比例	应收账款增减比例与营业收入增减比例比较
耐科装备	29,490.84	9.96%	13,431.29	25.50%	15.54%
本公司（剔除众合半导体后）	30,791.26	-2.06%	25,080.46	20.21%	22.27%

由上表可见，耐科装备营业收入增长比例为 9.96%，应收账款增长比例为 25.50%，应收账款增速高于营业收入增速，赊销规模有所扩大，与本公司的应收账款变化情况一致。

综上所述，公司赊销额增加与自身的经营情况及行业特征相符，具备合理性。

（二）应收账款收回风险评估

公司应收账款的主要客户为国内知名的封测类上市公司、大型国有产业集团以及行业内头部非上市企业，整体信用资质优良，具备较强的抗风险能力和支付能力。该类客户经营稳健、资信状况良好。且大部分赊销客户均为公司在手订单的活跃客户，双方保持着持续供货与结算的密切关系，通过持续业务合作有效监控客户的经营及回款情况。同时，公司已加强应收账款催收管理，建立相应的考核机制。公司应收账款的整体回收风险较低。

（三）预期信用损失率确定方法及过程和坏账准备计提的充分性分析

公司严格按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并计提坏账准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方

应收账款组合 2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中：账龄组合预期信用损失计提比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内	1%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	50%
5年以上	100%

公司上述的坏账计提政策保持一贯性。同时对应收账款严格区分单项计提与组合计提，对存在明显减值迹象、回款风险较高的款项单独进行单项减值测试，确保坏账准备计提的充分性。各期末坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比如下：

单位：万元

公司名称	2025年 12 月 31 日			2024年 12 月 31 日		
	应收账款余额	坏账准备余额	计提比例	应收账款余额	坏账准备余额	计提比例
耐科装备	13,431.29	1,779.22	13.25%	10,702.61	1,832.64	17.12%
本公司（剔除众合半导体后）	25,080.46	3,626.28	14.46%	20,863.86	3,122.17	14.96%

由上表可见，本公司 2025 年度坏账计提比例为 14.46%，2024 年末为 14.96%，整体计提比例与同行业基本可比，不存在明显偏低情形。

公司持续加强应收账款账期管理，定期评估下游行业资金周转情况、客户经营变化及履约能力，动态研判应收款项信用风险。并依据风险程度足额计提坏账准备，充分覆盖潜在回款损失。

总体上公司应收账款坏账准备计提充分、合理。

（四）会计师核查程序及核查意见

1、核查程序

（1）访谈公司销售负责人及财务负责人，了解 2025 年公司的信用政策是否发生变化，并获取相关内部审批文件；

（2）①获取应收账款账龄分析表，分析应收账款增长与营业收入增长的匹配关系；②结合市场竞争状况、客户信用状况、行业惯例等因素，分析赊销增加的原因及合理性；

（3）复核公司应收账款组合划分是否合理，评估预期信用损失率确定方法是否恰当；

（4）获取单项计提坏账准备的应收账款明细，评估单项计提认定是否合理、坏账计提是否充分；

（5）将公司坏账准备计提比例与同行业可比公司进行对比，分析是否存在显著差异。

2、核查意见

结合公司历史年度的坏账计提政策、坏账实际发生情况，以及同行业的坏账计提率的对比情况，公司的坏账计提充分、合理。

问题 3、关于资产情况

年报显示，公司期末存货账面价值 2.15 亿元，同比增长 127%，其中发出商品 1.04 亿元，占比 48.37%，上年同期仅 0.19 亿元。公司期末无形资产账面价值 1,386.14 万元，较期初大幅增长，主要系本期公司收购众合半导体无形资产评估增值所致，增值率 1,647.94%。长期股权投资期末账面价值 1,093.37 万元，主要为公司本期新增控股子公司众合半导体对外投资联营企业深圳平晨半导体科技有限公司所致。请公司补充披露：（1）分业务板块列示存货具体构成、库龄、存放地点，以及发出商品的发出时间、对应订单及客户情况、期后验收等，结合收入确认政策、发货及验收周期等，说明发出商品金额大幅增长的合理性；（2）存货可变现净值的计算方法和主要参数的确定依据，说明跌价准备的计提是否及时、充分；（3）无形资产的类型、名称、取得时间、取得方式、入账金额及确定依据、摊销政策等，是否满足无形资产确认条件，并量化分析确认大额无形资产对后续经营业绩的影响；（4）本期对外投资联营企业的交易背景、交易对手方等情况，说明众合半导体在被收购前夕对外投资的原因及合理性，是否存在利益输送的情形；（5）请年审会计师补充说明对存货执行的具体审计程序及结论，并对上述问题发表明确意见。

公司回复：

一、分业务板块列示存货具体构成、库龄、存放地点，以及发出商品的发出时间、对应订单及客户情况、期后验收等，结合收入确认政策、发货及验收周期等，说明发出商品金额大幅增长的合理性；

（一）分业务板块列示存货具体构成、库龄、存放地点

单位：万元

业务板块	存货项目	存放地点	账面金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
半导体封装装备	原材料	原材料库	2,413.13	1,556.58	288.37	361.36	206.83
半导体封装装备	在产品	生产车间	5,576.98	5,576.98	—	—	—
半导体封装装备	库存商品	成品库	2,740.26	1,568.92	279.78	282.59	608.97
半导体封装装备	发出商品	具体见发出商品统计表	10,685.61	9,066.82	1,339.26	210.97	78.56
半导体封装装备	合同履约成本		13.91	13.91	—	—	—
小计			21,429.89	17,773.21	1,907.41	854.91	894.36
冲压轴承座及配套密封件	原材料	原材料库	194.32	133.26	21.91	3.69	35.46
冲压轴承座及配套密封件	在产品	生产车间	156.10	156.10	—	—	—
冲压轴承座及配套密封件	库存商品	成品库	97.64	89.57	4.13	0.44	3.50
冲压轴承座及配套密封件	发出商品	具体见发出商品统计表	46.63	46.63	—	—	—
小计			494.68	425.56	26.04	4.13	38.96
塑料挤出模具及配套设备	原材料	原材料库	266.52	204.61	18.30	8.49	35.12
塑料挤出模具及配套设备	在产品	生产车间	592.26	592.26	—	—	—
塑料挤出模具及配套设备	库存商品	成品库	156.06	156.06	—	—	—
塑料挤出模具及配套设备	发出商品	具体见发出商品统计表	39.29	39.29	—	—	—
小计			1,054.13	992.22	18.30	8.49	35.12
总计			22,978.70	19,190.99	1,951.75	867.53	968.44

（二）发出商品的发出时间、对应订单及客户情况、期后验收、存放地点

期末发出商品总额为 10,771.53 万元，期后验收金额为 4,056.00 万元，期后验收比例为 37.65%。发出时间超过半年的金额为 5,472.84 万元，超过一年的金额为 2,684.61 万元。

期末发出商品主要由半导体封装装备构成，其金额为 10,685.61 万元，占比高达 99.20%。列示单笔期末余额 200 万元以上发出商品明细如下：

客户名称	订单号	发出时间	发出商品金额	期后验收金额	存放地点
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	SSORD0007762	2025/3/18	359.44	359.44	四川省遂宁市船山区经开区飞龙路 66 号
通富通科（南通）微电子有限公司	512025454	2025/5/20	273.30	—	南通市崇川区通京大道 5 号
华羿微电子股份有限公司	SSORD0001212	2025/11/26	268.69	—	西安市未央区经济技术开发区弘业一路
广东韶华科技有限公司	SSORD000936	2025/6/30	232.40	—	广东省韶关市武江区盛强路 98 号
广东韶华科技有限公司	SSORD000883	2025/6/30	218.46	—	广东省韶关市武江区盛强路 98 号
长电科技（宿迁）有限公司	512025451	2025/2/23	217.70	—	宿迁市宿城区苏宿工业园普陀山大道 5 号
通富微电子股份有限公司	SSORD001101	2025/9/28	210.73	—	江苏省南通市崇川开发区崇川路 288 号
常州振同世纪微电子股份有限公司	SSORD001034	2025/8/28	208.87	—	江苏省常州市新北区长江北路 19 号
总计			1,989.58	359.44	

注：发出商品时间较长未验收原因为：①部分发出商品为公司新品，公司与客户签订的为 DEMO（试用合同），客户的试用及磨合周期较长；②部分发出商品客户仍在调试验证中；③部分发出商品客户尚未进行批量验证，未验收。

（三）结合收入确认政策、发货及验收周期等，说明发出商品金额大幅增长的合理性

公司发出商品主要由半导体封装装备构成。收入确认政策如下：公司设备类产品收入确认政策为货物发往客户指定地点，安装调试完成并从客户处取得验收单据时确认收入。对于不需要安装调试的非设备类产品收入确认政策为公司将产品运至约定交货地点经买方签收确认收入。公司的收入确认政策各期保持一贯性。该类产品的发货及验收周期，根据产品型号及客户需求不同，产品完工后一般最迟于次月发货，从发货至安装调试完成并经客户验收确认通常在 6 个月左右，部分非标产品或新产品因客户的验证、试用及磨合周期较长，可能延长至 1 年以上。期末发出商品余额均为已发货尚未验收确认收入的产品，具体情况见“问题 3 一、（二）发出商品的发出时间、对应订单及客户情况、期后验收、存放地点”。

公司期末发出商品大幅增加，主要原因是本期合并众合半导体形成的期末发出商品余额较大，而期初发出商品余额并未包含众合半导体，按同口径模拟调整后的对比情况如下：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动额
发出商品	10,771.53	1,941.27	8,830.26
众合半导体期初发出商品		5,851.71	—
模拟调整后发出商品	10,771.53	7,792.98	2,978.55

模拟调整后的发出商品期末余额较期初余额增加 2,978.55 万元，增长率为 38.22%，主要原因系众合半导体 2025 年度新品 200T 封装系统、双轨道切筋成型系统等在手订单增加，以及富仕三佳、三佳山田 2025 年度第三季度订单增加所致。

（四）会计师核查程序及核查意见

1、核查程序

（1）了解、评价并测试公司与存货管理、收入确认相关的关键内部控制的设计与运行有效性，包括存货盘点制度、发出商品管理流程、收入确认时点等；

（2）获取发出商品明细清单，抽样检查发出商品对应的合同及关键条款、发出时间及发货单据、签收时间及签收单据等，分析确认发出商品的合理性；

（3）对发出商品执行函证程序；

（4）对大额发出商品执行现场监盘程序。

2、核查意见

公司发出商品金额大幅增长主要系收购众合半导体以及本期众合半导体、富仕三佳、三佳山田订单增加影响，具有商业合理性。

二、存货可变现净值的计算方法和主要参数的确定依据，说明跌价准备的计提是否及时、充分；

（一）存货可变现净值的计算方法和主要参数的确定依据，说明跌价准备的计提是否及时、充分

1、存货可变现净值的计算方法和主要参数的确定依据如下：

存货项目	计算方法	参数依据
库存商品、发出商品	已获取销售订单的产品，按存货成本高于其可变现净值的金额计提跌价准备，可变现净值 = 合同订单单价 *（1- 估计销售费用和相关税费率）* 结存数量	合同订单单价、合同约定价格
	尚未获取销售订单的产品，按存货成本高于其可变现净值的金额计提跌价准备，可变现净值 = 参考单价 *（1- 估计销售费用和相关税费率）* 结存数量	定制化产品结合客户意向价格及历史同类成交价综合确定，标准化产品选取当期平均销售单价或者市场报价
	因质量问题等，已明确无法实现销售的产品全额计提跌价准备	可变现净值为 0
	长库龄产品，针对不同情况综合考虑各种因素，按照预计可收回金额计提	结合长库龄原因、是否预收货款、预计发生的改造费用以及预计形成销售的时间等因素，评估存货跌价风险并计提相应跌价
原材料	呆滞、无法使用的原材料全额计提跌价	可变现净值为 0
	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值	估计售价：定制化产品结合订单价格或客户意向价格及历史同类成交价综合确定，标准化产品选取当期平均销售单价或者市场报价
在产品	受市场波动，客户暂无需求不提货，对应生产订单的在产品全额计提跌价准备	可变现净值为 0
	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值	估计售价：定制化产品结合订单价格或客户意向价格及历史同类成交价综合确定，标准化产品选取当期平均销售单价或者市场报价

2、公司以及同行业可比公司存货跌价准备计提比例列示如下：

单位：万元

公司名称	2025年 12 月 31 日			2024年 12 月 31 日		
	存货余额	存货跌价准备余额	计提比例	存货余额	存货跌价准备余额	计提比例
耐科装备	14,006.29	580.90	4.13%	14,613.68	362.39	2.48%
本公司	22,978.70	1,443.54	6.28%	10,329.73	842.76	8.16%

由上表可见，公司存货跌价计提比例高于同行业耐科装备，公司在日常管理过程中亦密切关注存货状态及库龄情况，充分评价存货跌价风险，及时并充分的计提存货跌价准备。

（二）会计师核查程序及核查意见

1、核查程序

（1）了解、评价并测试公司与存货可变现净值相关的关键内部控制的设计与运行有效性；

（2）针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

（3）选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格等一致；

（4）评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；

（5）测试管理层对存货可变现净值计算是否准确；

（6）结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、破损或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

（7）检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、核查意见

报告期内，公司已按照存货可变现净值计算方法确认存货跌价准备，存货跌价准备的计提及时、充分。

三、无形资产的类型、名称、取得时间、取得方式、入账金额及确定依据、摊销政策等，是否满足无形资产确认条件，并量化分析确认大额无形资产对后续经营业绩的影响；

（一）无形资产的类型、名称、取得时间、取得方式、入账金额及确定依据、摊销政策等

1、无形资产的类型、名称、取得时间、取得方式

三佳科技收购众合半导体导致期末无形资产增加金额为 1,286.56 万元，其中评估增值部分为 1,221.84 万元，占比 94.97%。评估增值部分包括众合半导体和全资子公司安徽大华半导体科技有限公司（以下简称：大华半导体）无形资产共计 96 项，其中，专利 72 项、软件著作权 20 项、商标 4 项，专利及软件著作权为生产经营过程中技术创造、改进的成果，来源于自身研发，其取得成本在历史期均已费用化。商标取得成本为申请费用及维护费，费用金额较小，在取得时一次性费用化。截至评估基准日，上述无形资产的账面价值均为 0，因而属于表外资产，具体明细如下：

（1）专利

序号	内容或名称	权利人	类型	专利申请号	专利申请日期	公告日期	取得方式
1	一种用于封装大基板的真空压缩模具	众合半导体	发明公布	CN202411797416.0	2024-12-09	2025-04-18	原始取得
2	一种适用于双注塑系统的高效稳定型翻转机构	众合半导体	发明公布	CN202411734267.3	2024-11-29	2025-02-25	原始取得
3	一种半导体自动切筋成型用夹爪	众合半导体	发明公布	CN202411517228.5	2024-11-05	2025-02-18	原始取得
4	一种半导体树脂振动排列机构	众合半导体	发明公布	CN202411813385.4	2024-12-11	2025-01-10	原始取得
5	一种集成电路塑封设备树脂直线上料机构	众合半导体	发明公布	CN202411607470.4	2024-11-12	2025-01-03	原始取得
6	一种等距离变距芯片装盘装置	众合半导体	发明公布	CN202411458214.3	2024-10-18	2024-12-10	原始取得
7	一种用于双注塑系统的去毛刺上折机构	众合半导体	发明公布	CN202410755430.8	2024-06-12	2024-09-20	原始取得
8	一种具有来料检测功能的拣爪送料机构	众合半导体	发明授权	CN202311696832.7	2023-12-11	2024-06-14	原始取得
9	一种半导体引线框架移动预热机构及预热方法	众合半导体	发明授权	CN202410004264.2	2024-01-11	2024-04-09	原始取得
10	一种半导体塑封机用树脂夹持转移机构	众合半导体	发明公布	CN202311840360.4	2023-12-28	2024-03-29	原始取得
11	一种双条带自动快速转换切筋模具	众合半导体	发明公布	CN202410005434.1	2024-01-15	2024-02-27	原始取得
12	一种半导体引线框架检测装置及方法	众合半导体	发明公布	CN202311822935.5	2023-09-13	2024-01-05	原始取得
13	一种用于半导体塑封双注塑合模装置	众合半导体	发明公布	CN202311345046.2	2023-10-17	2023-12-26	原始取得
14	一种 PCB 基板的封装模具	众合半导体	实用新型	CN202320785911.4	2023-04-11	2023-10-13	原始取得
15	一种压平框架的简易装置	众合半导体	实用新型	CN202320325075.1	2023-02-27	2023-08-18	原始取得
16	一种半导体芯片自动封装系统的控制方法及控制系统	众合半导体	发明公布	CN202310533455.9	2023-05-12	2023-07-28	原始取得
17	一种柔性连接 XY 轴双向移载机构	众合半导体	实用新型	CN202320325796.2	2023-02-27	2023-07-07	原始取得
18	一种旋转上料抓手	众合半导体	实用新型	CN202320214717.0	2023-02-15	2023-06-23	原始取得
19	一种卡料检测带自动复位的盘料装置	众合半导体	实用新型	CN202320320753.6	2023-02-16	2023-06-23	原始取得
20	一种半导体胶料上料装置	众合半导体	发明公布	CN202211502974.0	2022-11-28	2023-06-09	原始取得
21	半导体封装模具	众合半导体	发明授权	CN201710397516.8	2017-05-31	2023-02-14	原始取得
22	一种半导体基板预热高水线上料机构及高水线	众合半导体	发明公布	CN202211167483.5	2022-09-23	2022-12-30	原始取得
23	一种集成电路塑封设备的树脂料移送装置	众合半导体	发明授权	CN201710397562.8	2017-05-31	2022-08-26	原始取得
24	一种可自动排废的冲切机	众合半导体	发明授权	CN201910454930.2	2019-05-29	2021-07-13	原始取得
25	一种切筋成型装置	众合半导体	发明授权	CN201910458796.4	2019-05-29	2021-06-15	原始取得
26	用于半导体封装系统的引线框架风扇系统	大华半导体	发明授权	CN201610330825.9	2016-5-17	2018-11-13	原始取得
27	塑封模具清洁装置	大华半导体	发明授权	CN201610330894.6	2016-5-17	2018-3-13	原始取得
28	塑封模具用自动清扫吸尘装置	大华半导体	发明授权	CN201610330901.6	2016-5-17	2018-2-23	原始取得
29	料盒自动装夹机构	大华半导体	发明授权	CN201610920064.2	2016-10-21	2018-7-24	原始取得
30	一种带缺陷检测功能的料饼上料装置	大华半导体	发明授权	CN201810869325.1	2018-8-2	2020年9月8日	原始取得
31	一种半导体芯片引脚成型缺陷检测的方法	大华半导体	发明授权	CN201810869324.7	2018-8-2	2021-7-20	原始取得
32	一种引线框架的拨动移送装置及方法	大华半导体	发明授权	CN201811397007.6	2018-11-22	2021-8-24	原始取得
33	一种适用于切筋成型系统的移料装置	大华半导体	发明授权	CN201910458779.4	2019-5-29	2021-6-15	原始取得
34	一种宽度可调节的进料装置	大华半导体	发明授权	CN201910458765.2	2019-5-29	2021-6-15	原始取得
35	一种用于自动封装系统的下拆式去离道装置	大华半导体	发明授权	CN201811065839.8	2018-9-13	2023-10-31	原始取得
36	一种斜滑式上料装置	大华半导体	发明授权	CN201811065823.7	2018-9-13	2023-11-24	原始取得
37	芯片引线框架的自动排放控制方法及系统	大华半导体	发明授权	CN2020102523.15	2020-4-1	2024-3-1	原始取得
38	一种芯片料饼自动投放控制方法及系统	大华半导体	发明授权	CN202010252162.9	2020-4-1	2021-10-26	原始取得
39	半导体切筋成型系统自动换管机构	大华半导体	发明授权	CN202011158966.X	2020-10-27	2021-1-15	原始取得
40	半导体自动切筋系统电机驱动的送料机构	大华半导体	发明授权	CN202011157503.1	2020-10-27	2021-1-15	原始取得
41	芯片半自动模具	大华半导体	发明授权	CN202110394975.7	2021-4-13	2021-12-10	原始取得
42	用于集成电路芯片封装灌膜的装置	大华半导体	发明授权	CN202110434833.3	2021-4-22	2021-12-3	原始取得
43	一种防过载芯片推出装置	大华半导体	发明授权	CN202210064475.7	2022-8-12	2022-11-4	原始取得
44	一种旋转位定位及到位检查装置	大华半导体	发明授权	CN202211015565.4	2022-8-24	2022-11-22	原始取得
45	一种 QFN 大基板的封装模具及方法	大华半导体	发明授权	CN202211243605.4	2022-10-12	2022-12-27	原始取得
46	用于薄型阵列芯片的覆膜式塑封模具	大华半导体	发明授权	CN202110546922.5	2021-5-19	2021-7-9	原始取得
47	树脂塑料搬运装置	大华半导体	实用新型	CN201622146437.0	2016-10-21	2017-5-24	原始取得
48	一种电动封节式压力机	大华半导体	实用新型	CN201622146406.5	2016-10-21	2017-5-24	原始取得
49	一种用于半导体封装设备的上料机